

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-074

宇环数控机床股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司“湖南宇环精研半导体科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“宇环精研”），并授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

- 企业名称：湖南宇环精研半导体科技有限公司
- 注册资本：5000 万元人民币
- 公司类型：有限公司
- 经营范围：新材料及半导体器件专用设备制造、销售；磨削耗材专用化学产品销售（不含危险化学品）；数控机床制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
- 注册地址：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号
- 股权结构：公司持有其 100% 股权

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

三、出资方式及资金来源

- 1、出资方式：现金出资；
- 2、资金来源：公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

经过多年积累，公司在精密高效磨削抛光领域形成了完整的研发体系和工艺特色，基于既有的技术优势，根据半导体产业领域的磨抛设备加工需求和公司前期市场业务开发推进计划，为了更好地推动新业务开展，公司拟投资设立宇环精研，以集中技术和人力资源专业开发半导体加工相关设备，进一步拓展公司产品的市场领域，打造公司未来战略发展新的业务增长点。

本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

本次投资可能面临着行业政策、市场环境、经营、管理等不确定因素带来的风险，可能存在无法实现预期收益的风险。公司将密切关注宏观经济和政策环境的变化，跟踪行业发展和市场趋势；同时，公司将秉承精细化管理理念，加强内部半导体产业的协同效应，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023年11月28日